

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 23 日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/057647 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/52, C09J 183/07 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018766
- (22) 国際出願日: 2004 年 12 月 9 日 (09.12.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-411502
2003 年 12 月 10 日 (10.12.2003) JP
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ジーイー東芝シリコン株式会社 (GE TOSHIBA SILICONES CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1060032 東京都港区六本木 6 丁目 2 番 3 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田村 長 (TAMURA, Osamu). 平井 信男 (HIRAI, Nobuo).
- (74) 代理人: 古谷 聡, 外 (FURUYA, Satoshi et al.); 〒1030007 東京都中央区日本橋浜町 2 - 1 7 - 8 浜町花長ビル 6 階 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SILICONE ADHESIVE AGENT

(54) 発明の名称: シリコン接着剤

(57) Abstract: A silicone adhesive agent for joining a semiconductor pellet and a member for mounting said pellet, which comprises an addition reaction curing type silicone rubber composition exhibiting a stain onto a glass plate during curing by heating of a contact angle on the glass of 70° or less. The silicone adhesive agent does not lower the wire bondability and also does not lower the adhesion between the surface of a semiconductor pellet or a lead frame and a sealing resin.

(57) 要約: 本発明は、ワイヤボンダビリティーを低下せず、更に半導体ペレット表面およびリードフレームと封止樹脂との密着性が低下しないシリコン接着剤を提供する。詳しくは、加熱硬化時におけるガラス板への汚染が、ガラス板上の接触角 70° 以下である付加反応硬化型シリコンゴム組成物からなる、半導体ペレットと該ペレット取付部材とを接合するためのシリコン接着剤である。

WO 2005/057647 A1